技術詞彙表

本技術詞彙表包含本文件中與本公司及我們的業務有關的部分術語的解釋。本技術詞彙表中包含的術語及其涵義可能與這些術語的標準行業涵義或用法不一致。

「AA」或「主動校準」	指	一種動態調校過程，透過即時反饋傳感器的輸出訊號精確校準鏡頭與影像傳感器的相對位置、傾斜角度及焦點，藉此確保最佳影像品質
「ADAS」	指	先進駕駛輔助系統，由多種元件、傳感器及控制器所構成，與人類駕駛員共同確保車輛正確且安全地行駛，實現L1至L2等級的自動駕駛
「AI」	指	人工智能，使用機器(尤其是電腦系統)模擬人類的智能程序
「算法」	指	清晰指令的有限序列，通常用於解決某類特定問題或進行計算
「AR」或「擴增實境」	指	一種透過顯示器(例如手持裝置或頭戴式顯示器)將實時三維渲染的電腦圖形疊加於現實世界局部區域的技術
「CAGR」	指	複合年增長率
「攝像頭模組」	指	一種小巧緊湊的整合組件，包括鏡頭、影像傳感器及安裝在 PCB 上的支援電路，可擷取影像並將影像轉換為數位資料
「CNAS」	指	中國合格評定國家認可委員會
「COB」	指	板上芯片，將半導體處理器芯片或晶粒直接安裝在其最終電路板並作電力互連的技術
「倒裝芯片」	指	一種將晶粒(例如半導體裝置、集成電路芯片、集成無源器件及微機電系統)透過沉積於芯片焊盤上的焊錫凸點與外部電路相互連接的方法
「物聯網」	指	物聯網，通過互聯網或其他通訊網絡與其他設備及系統連接並交換數據，且帶有傳感器、處理能力、軟件及其他技術的實際物件(或多組有關物件)
「LED」	指	發光二極管，一種在電流通過時發光的半導體二極管

技術詞彙表

「激光雷達」	指	光檢測和測距，一種通過使用激光瞄準物體或表面並測量反射光返回至接收器的時間，從而確定距離的方法
「MicroLED」	指	芯片尺寸小於100微米的發光二極管
「裸眼 3D」	指	一種利用視差障礙或光柵鏡片等技術，將不同的影像導向每隻眼睛，誘導大腦的深度感知，讓觀眾毋須佩戴特殊眼鏡亦能看到 3D 影像的技術
「OEM」	指	原始設備製造，指按照客戶的產品規格製造產品並以客戶的品牌出售之公司
「PCB」	指	印刷電路板，為絕緣物料的平板或底板，其上備有導體物料形成的佈圖，當組件被安裝及焊接到其上時則形成電子電路
「平方米」	指	平方米
「基板」	指	一種可應用在半導體器件及其他電子部件上的固體物質
「表面貼裝技術」	指	為將電子元件直接安裝於基板的表面增加電路板容量、促進產品小型化及實現先進生產自動化的過程
「ToF」	指	飛時測距，物體、粒子或波於介質中行進一段距離所耗費的時間之測量
「VCM」或「音圈馬達」	指	一種簡單的非換向式電動執行器，利用永久磁鐵的磁場與通電線圈之間的相互作用產生線性運動
「VR」	指	虛擬實境，一種採用三維近眼顯示器及姿勢追蹤，給予用戶仿如身臨其境的虛擬世界模擬體驗
「XR」	指	擴展實境，為融合實體與數位世界的技術(包括虛擬實境、擴增實境及混合現實)之總稱
「μm」	指	微米，為相當於一百萬分之一米(10^{-6}米)或千分之一毫米的長度單位
「3D」	指	三維